

Gudeng Precision Industrial Co. Ltd

家登精密工業股份有限公司



2025.03

Partner with **H.E.A.R.T.** , Grow with **P.A.S.S.I.ON.**

發言人：沈恩年 營運長 暨 發言人
電話：(02)2268-9141
郵件：AmyShen@gudeng.com



免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述，是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知不確定性的影響，實際結果將可能於表述內容不同，以上所提供之所有資訊僅供參考，實際資料請參考公開資訊觀測站。

另除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。



家登-先進載具設備領航者



美國家宇

美國家登/德鑫半導體

韓國家登

日本家登

家登土城總部
家登創投
家登復興廠

協力廠重慶廠

上海

中壢

竹北

台北

家碩科技

家崎科技

家登昆山廠

上海家登

家登樹谷廠

台南

岡山

朝宇航太

- 成立於：1998年3月20日
- 員工數：1100 up
- 實收資本額：NT 942,972,320
- 集團2020營業額：NT 25 億元
- 集團2021營業額：NT 31.2 億元
- 集團2022營業額：NT 44.9 億元
- 集團2023營業額：NT 50.8 億元 (與前年成長13%)
- 集團2024營業額：NT 65.5 億元 (與去年同期成長29%)
- 主力產品：

半導體事業

- ① 光罩傳載解決方案
- ② 晶圓傳載解決方案
- ③ 半導體機台設備
- ④ 其他服務

航太事業

- ① 動力液壓阻尼油缸
- ② 液壓傳輸高壓導管
- ③ 動態平衡馬達基座
- ④ 正負壓熱傳導隔片



半導體產業展望

由於2025年全球人工智慧 (AI) 與高效能運算 (HPC) 需求持續攀升，從雲端資料中心、終端裝置到特定產業類別，各個主要應用市場均面臨規格升級趨勢，半導體產業將再度迎來嶄新榮景，**預計2025年整體半導體市場將成長超過15%**。在AI晶片需求爆炸性成長之下，預估全球半導體市場將在2027年達到7,000-8,000億美元規模，且業界已有共識認為**2030年市場可望突破1兆美元**。

AI應用將加速邏輯晶片、記憶體與封裝技術發展，為求晶片整體性能與功耗效率提升，**CoWoS 先進封裝技術**在整合運算晶片與記憶體方面也扮演關鍵角色，反映出現代電子設計面臨的挑戰，半導體技術整合也更加關鍵。此外，散熱成為在高效率的運算系統下支撐電子產品穩定運作的重要一環，各廠開始規劃導入不同的散熱解決方案，帶動相關供應鏈發展。未來隨著**生成式AI、CoWoS以及其他高速運算應用對半導體技術的持續需求**，在**先進製程**和**3D封裝技術**方面將帶來顯著的市場增長。

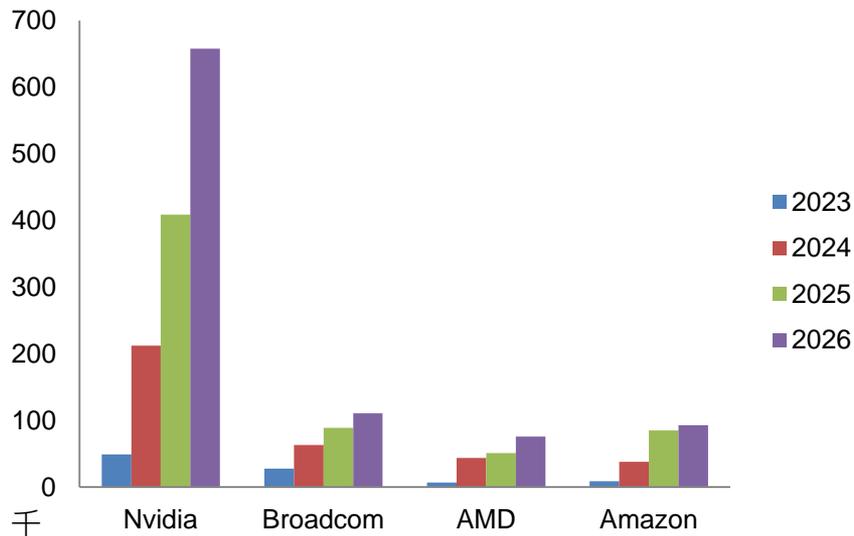


資料: 資策會MIC、IDC Research

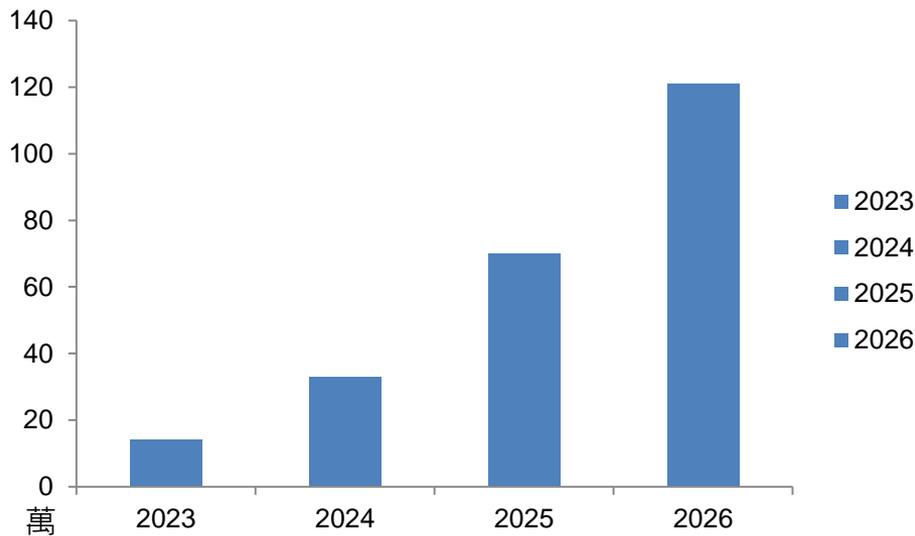


家登精密

CoWoS及主要 AI 晶片終端需求



關鍵客戶CoWoS產能預測



市場對於高運算晶片需求持續增加，關鍵客戶國內外先進製程布局，預估**2025年底CoWoS晶圓月產能可達7萬片，2026年底超過10萬片。**

資料: GFHK



關鍵客戶先進製程/封裝布局



家登精密

熊本廠 Fab23(P1~P2)
6/7/12/16/22/28 奈米
P1: 2024年底量產
P2: 2027年底量產

新竹廠 Fab20(P1~P4)
2 奈米
2025下半年量產
AP1(RD)

在美再投資**1000億美元**
未來將新增
3座晶圓廠
2座先進封裝設施
1座研發中心

德國德勒斯登廠
車用晶片
2027年量產

華盛頓廠 Fab 11

嘉科廠
擴充先進製程
2026年量產

加州 RD中心

德州 RD中心

台南廠 Fab18(P1~P8)
5/4/3 奈米
AP2/ AP8 (2025年底啟用)

台中/中科廠
2 奈米
2027年完工
AP5
2025上半年啟用

亞利桑那廠 Fab21(P1~P3)
4/3/2 奈米
P1: 2024年底量產
P2: 2028年量產
P3: 2030年量產

高雄廠 Fab22(P1~P3)
2 奈米
2025下半年量產

資料: 中央通訊社/ 數位時代



半導體在地供應鏈聯盟_德鑫



「全球關鍵性材料及創新技術的整合服務商」
打造台灣半導體國家隊

家登精密

家登集團
(家碩)
3680/6953
邱銘乾 董事長
詹印豐 總經理

全球半導體載具
解決方案領航者

迅得
6438
王年清 董事長

高階製程機台儲存及
定位系統整合專家

家登持有8.86%

科嶠
4542
鄧全凱 董事長
吳明致 總經理

CoWoS載具
清洗設備領航者

家登持有7.57%

奇鼎
6849
鄭智文 董事長

精密製程
環境控制專家

家登持有1.72%

Ecosystem 一站式解決方案

整合上中下游客戶、供應商，
打造出兼具彈性與
效率的服務平台

EUV關鍵組件
提升良率專家

意德士
7556
關聖哲 董事長

先進製程超高潔淨及
無塵室環境濾材專家

濾能
6823
黃銘文 董事長

EUV光罩式精密感測
儀器製造供應商

微程式
7721
吳騰彥 董事長

家登持有7.99%

先進製程載具
微污染防治專業供應商

聖凰
周傳華 董事長



半導體在地供應鏈聯盟_德鑫貳



「全球關鍵性材料及創新技術的整合服務商」
打造台灣半導體國家隊

家登精密

聯策 6658 林文彬 董事長	精密製程 檢測機台專家
-------------------------------------	------------------------------

維田 6570 李傳德 董事長	工業智能應用 智慧化工廠專家
-------------------------------------	---------------------------------

頌勝 7768 朱銘癸 董事長	半導體關鍵 耗材供應商
-------------------------------------	------------------------------

新應材 4749 詹文雄 董事長	電子特用化學 材料供應商
--------------------------------------	-------------------------------

圓達 莊明郎 董事長	半導體精密零件 檢測及研發專家
----------------------	----------------------------------

Ecosystem
一站式解決方案

整合上中下游客戶、供應商，
 打造出兼具彈性與
 效率的服務平台

高科技電子純水系 統設計專家	康淳 林守堂 董事長
---------------------------------	----------------------

高階先進製程及封裝 關鍵材料供應商	耐特 陳勳森 董事長
------------------------------------	----------------------

家登持有5%

高頻高速及低損耗 之PCB應用專家	邑昇 5291 簡榮坤 董事長
------------------------------------	-------------------------------------

先進封裝製程提升 良率專家	印能 7734 洪誌宏 董事長
--------------------------------	-------------------------------------

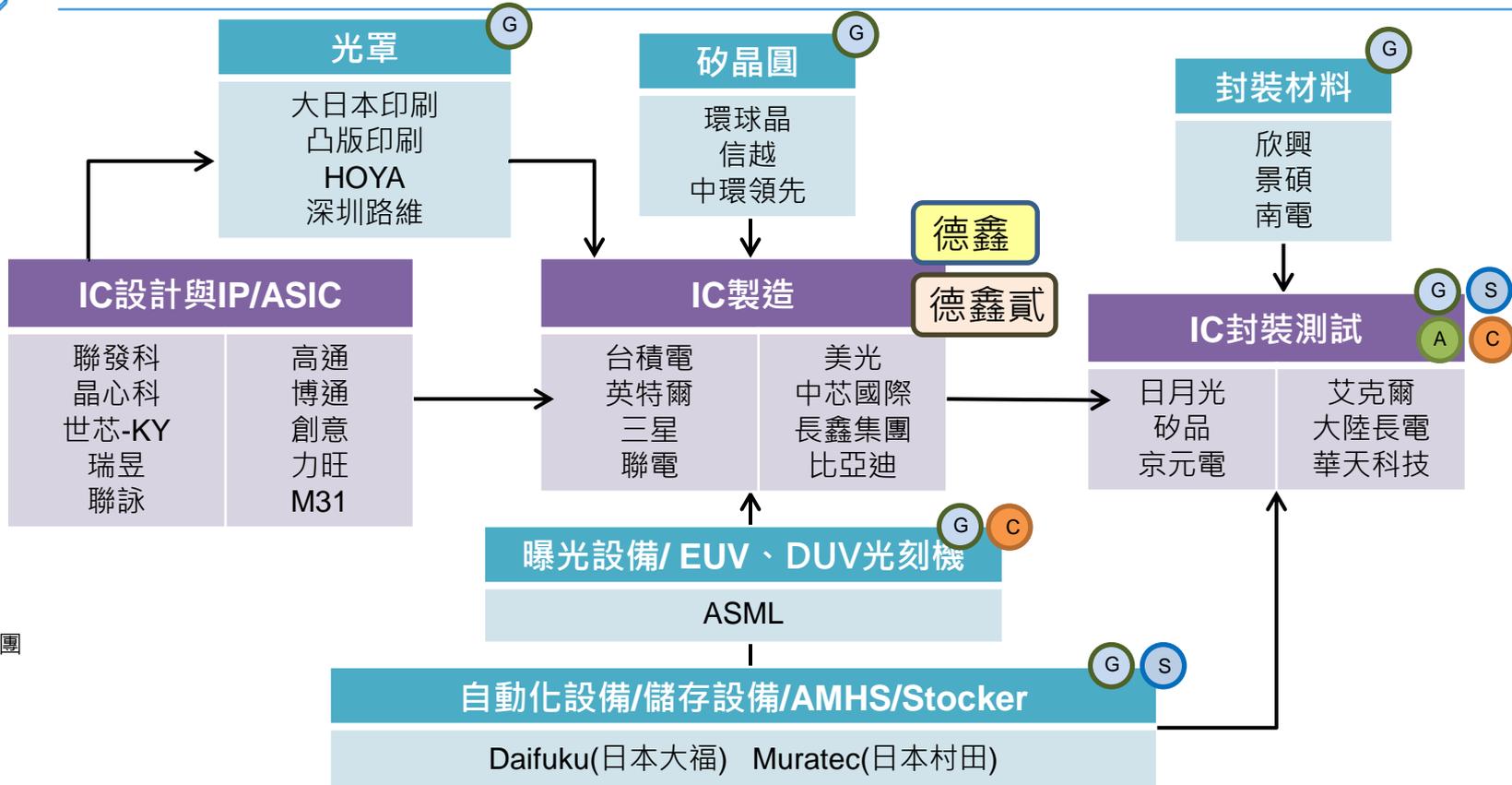
半導體應用機台及 化學鍍膜專家	友威 3580 李原吉 董事長
----------------------------------	-------------------------------------



半導體產業供應鏈



家登精密



- (G) 家登集團
- (S) 迅得
- (A) 科嶠
- (C) 奇鼎



大中華先進製程發展

中美貿易戰帶來地緣政治不確定性，美國政府祭出多項AI進出口限制，對出口先進晶片的代工廠和封裝公司實施更嚴謹要求，大中華地區客戶轉向積極發展先進製程提高在地產能

公司	地區	技術	月產能	公司	地區	技術	月產能
SMIC	上海	7 nm and below	50K	CXMT	合肥/北京	DRAM	300K
SMIC	北京	7 nm / 14 nm	50K	CXMT	上海	DRAM	>100K
華力	上海	7 nm	20K	YMTC	武漢	NAND	300K
華為	上海	7 nm	20K	YMTC	武漢	DRAM	50K
華為	深圳	7 nm / 14 nm	30-50K	Swaysure	深圳	DRAM	100K

大中華關鍵客戶產能規劃，先進製程月產能預計超過**15萬片**



家登集團2025年大中華市場布局



山東省

- 芯恩 (青島) (8" /12")
- 青島物元(12")
- 濟南比亞迪(8")
- 擎方科技 (Blank)
- 濟南泉意(Mask)

浙江省

- 杭州積海(12")
- 富芯半導體(12")
- 浙江創芯(12")
- 杭州士蘭(8")
- 長電紹興(後段)

重慶市

- 重慶萬國(12")
- 潤西微電子(12")

江蘇省

- 南京台積(12")
- 無錫卓勝微(12")
- 無錫海力士(8" /12")
- 長電先進(後段)
- 蘇州矽科 (後段)
- 南京芯德(後段)
- 無錫中微(Mask)
- 無錫迪斯(Mask)

• 華為體系

成都市

- 成都路維(Mask)
- 成都比亞迪(12")

廣東省

- 深圳昇維旭(12")
- 深圳鵬新旭(12")
- 深圳鵬芯微(12")
- 東莞光茂(12")
- 廣州粵芯(12")
- 深圳中芯(12")
- 東莞銳信(後段)
- 廣州新銳光(Mask)
- 深圳路維(Mask)
- 深圳清溢(Mask)
- 珠海龍圖(Mask)

遼寧省

- Intel大連(12")

北京市/天津

- 北京中芯(12")
- 中芯京城(12")
- 長鑫集電(12")
- 北京燕東(8" /12")
- 賽萊克斯(8")
- 天津中芯(8")

上海市

- 中芯國際(12")
- 中芯東方(12")
- 上海光通信(12")
- 上海集成(12")
- 積塔半導體(8" /12")
- 台積電-十廠(8")
- 先進半導體(8")
- 上海凸版(Mask)
- 上海新昇(Wafer)
- 上海超硅(Wafer)

陝西省

- 西安奕斯偉(Wafer)

湖北省

- 武漢楚興(12")
- 武漢新芯(12")
- 武漢高芯(8")
- 長江存儲(12")

安徽省

- 長鑫新橋(12")
- 長鑫存儲(12")
- 合肥晶合(12")
- 合肥視涯(12")
- 合肥沛頓(後段)
- 合肥清溢(mask)
- 合肥合光(mask)

福建省

- 廈門聯芯(12")
- JHICC(晋华) (12")
- 廈門士蘭(12")
- 渠梁電子(後段)
- 廈門美日(mask)

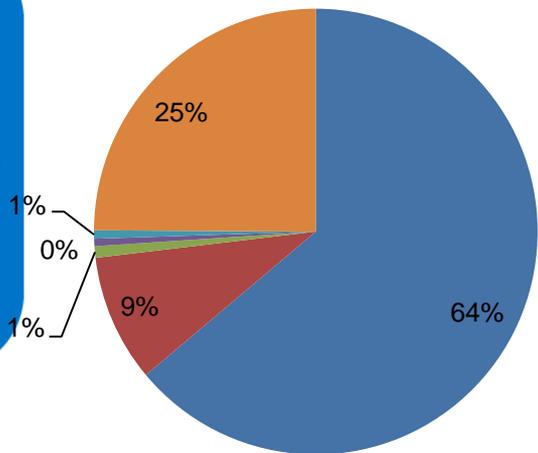


家登本業營收地區表現

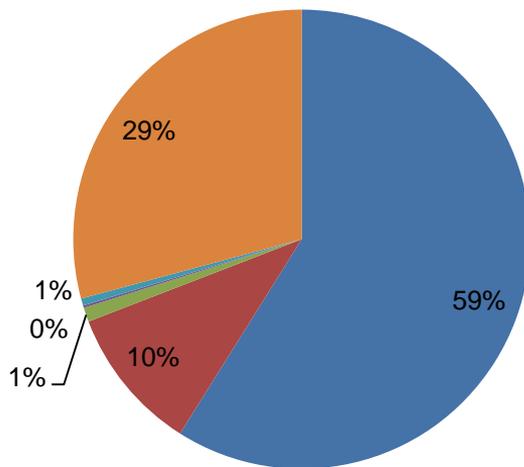


家登精密

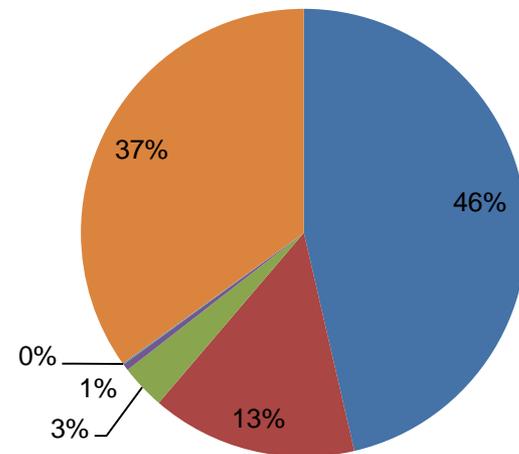
2022



2023



2024



■ 台灣 ■ 美國 ■ 日韓 ■ 其他 ■ 歐洲 ■ 大中華



半導體客戶分布

家登精密

Logic/Power Foundry&IDM.

PCB/OSTA (Outsourced Semiconductor Assembly and Test)

Memory Foundry&IDM.

Reticle /Mask

Equipment



家登擴廠計畫



● 家登精密
● 重要客戶

日本久留米廠
半導體暨航太產能
2027年Q2完工



德國德勒斯登廠
ESMC

昆山廠/重慶協力廠
大中華半導體產能
昆山二期
大中華半導體產能
2024年10月啟用

TSMC熊本廠
Fab23(P1~P2)

TSMC台南廠
Fab18(P1~P8)

TSMC高雄廠
Fab22(P1~P3)

TSMC新竹廠
Fab20(P1~P4)

TSMC中科廠
Fab15

TSMC華盛頓廠

TSMC亞利桑那廠
Fab21(P1~P3)

復興廠
半導體產能
家崎大樓
Cooling生產暨研發總部
2025年Q2完工
龍福一、二廠
半導體暨航太產能
2025年Q4啟用



美國子公司
倉儲/FAE
2024年1月啟用

家登樹谷廠
半導體及航太產能
家登樹谷廠二期(久久大樓)
半導體暨航太產能
無塵室(3F)2024年12月啟用
1F、2F、4F 2025年下半年投產

南科三期
半導體、航太及家碩產能
2029年Q1啟用

彰化花壇廠
新事業生產基地
2028年Q2完工





半導體製程

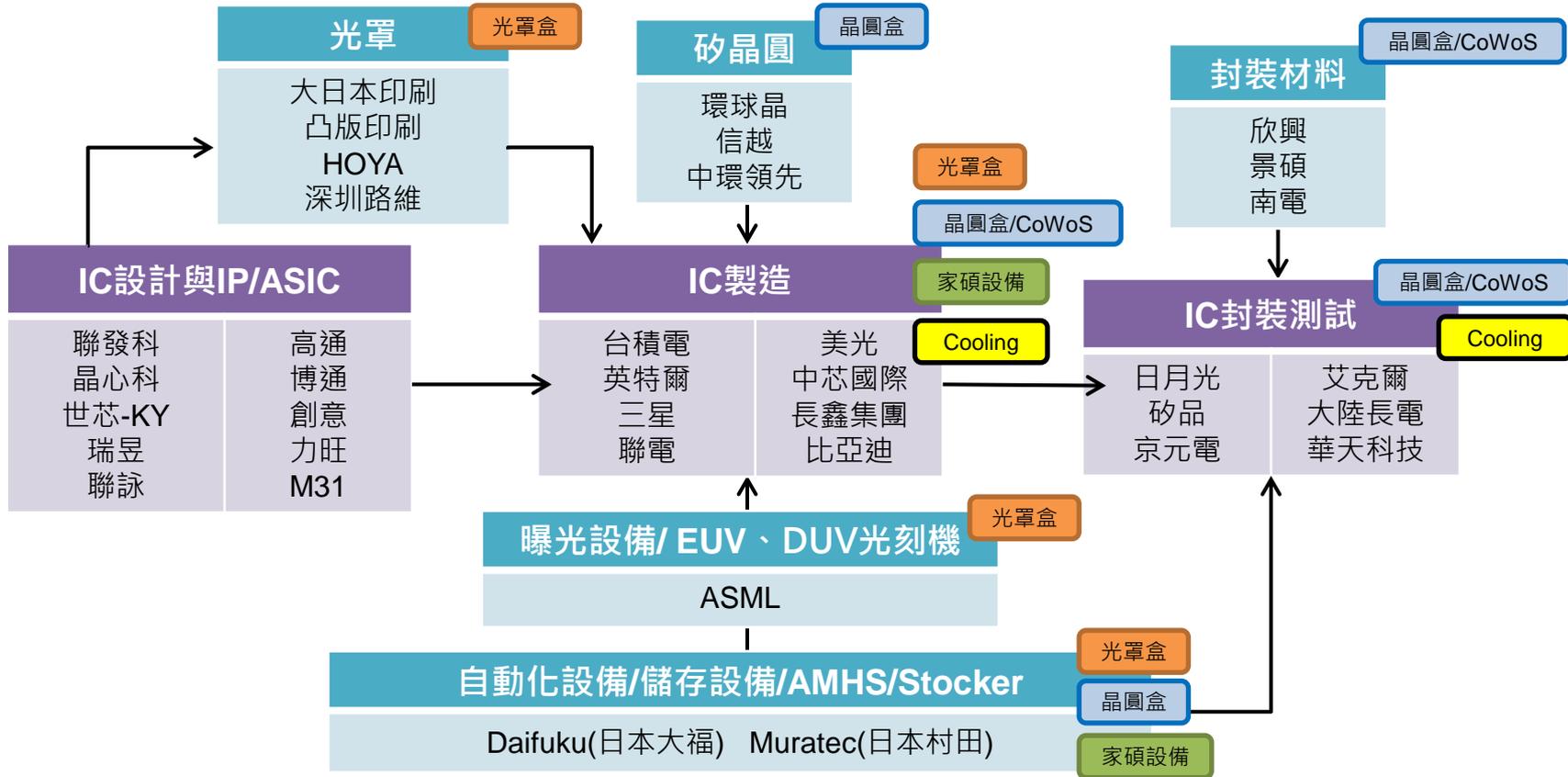
- AI
- 航太
- 通訊
- 汽車
- 消費電子
- 國防





半導體產業供應鏈

家登精密





先進封裝技術-家登全系列解決方案



300 FOUNDRY/FOSB

Film Frame FOUNDRY



Film Frame FOUNDRY

2023

8"/12"

wafer processing transport

Tape frame FOUNDRY

2025

SEMI E185

300*300

wafer processing transport



Full Panel Shipper

2024

510*515

Horizontal Panel shipping box

Quarter Panel FOUNDRY

2021

2025

SEMI E62 (door)
E47.1 (shell)
E57 (KC)

243*241

300*300

1/4 Panel product transport

Panel FOUNDRY

410/450 Glass Shipping Box

2025

Raw material shipping box

Full Panel FOUNDRY

SEMI E181

2025

2023

2022

600*600

510*515

510*510

Panel processing transport

IC Tray FOUNDRY

SEMI E185

SEMI E47
SEMI E62

2025

2017

Tape Frame FOUNDRY

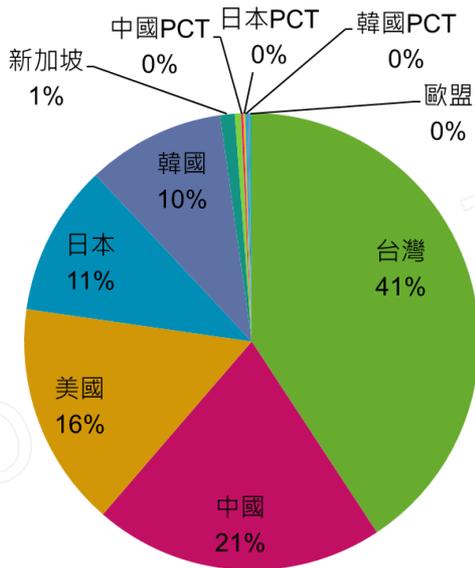
Tray FOUNDRY

Tray & Magazine

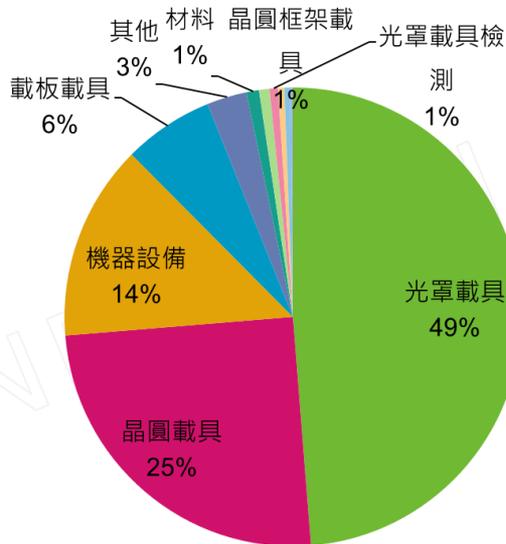
IC product transport



專利地區別



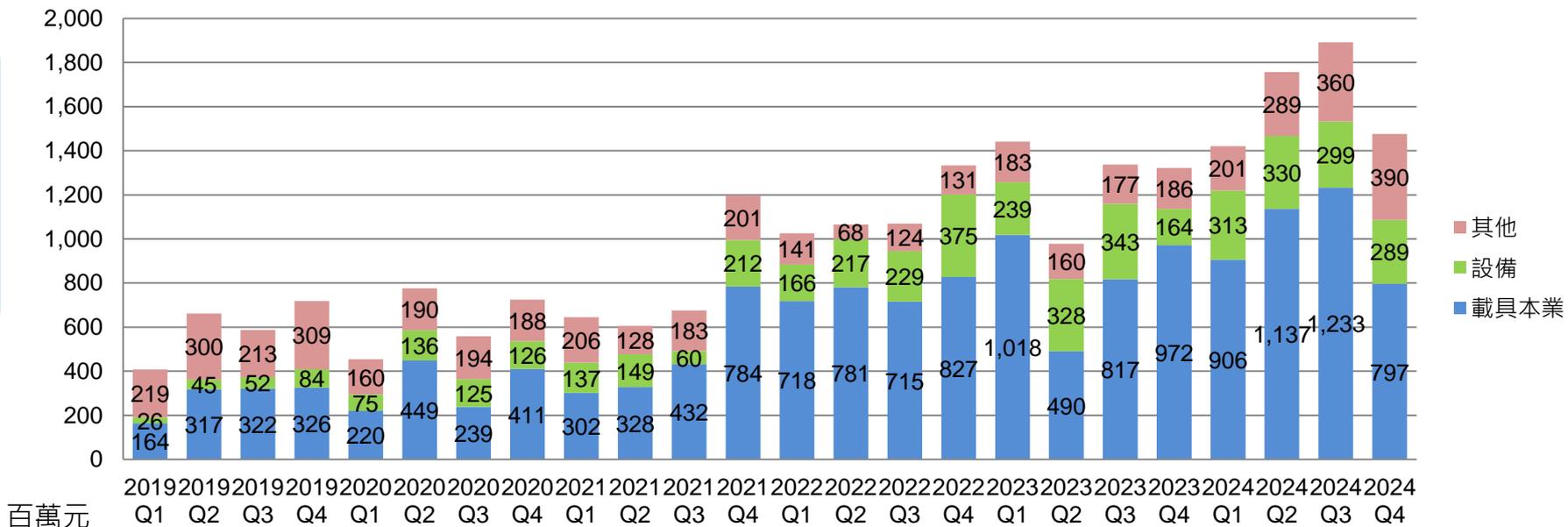
專利產品別



截至2025年3月，獲得國內外**702**項專利的肯定，持續建構高技術含量之專利版圖

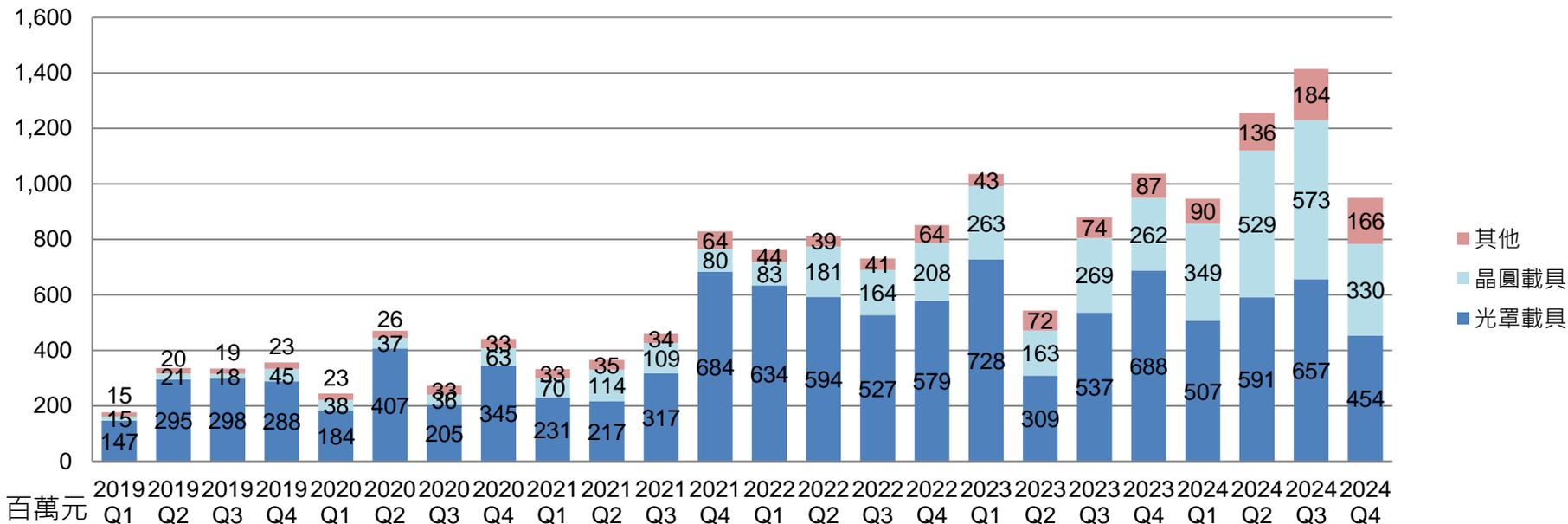


家登集團合併營收



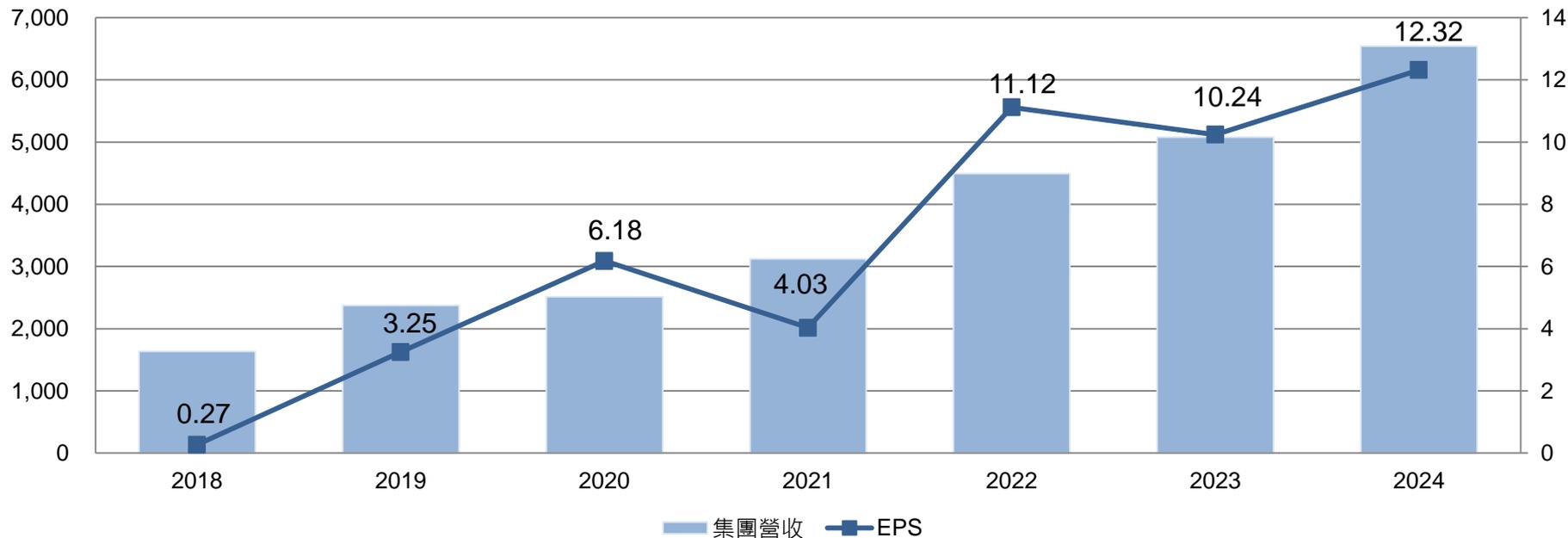


家登本業營收



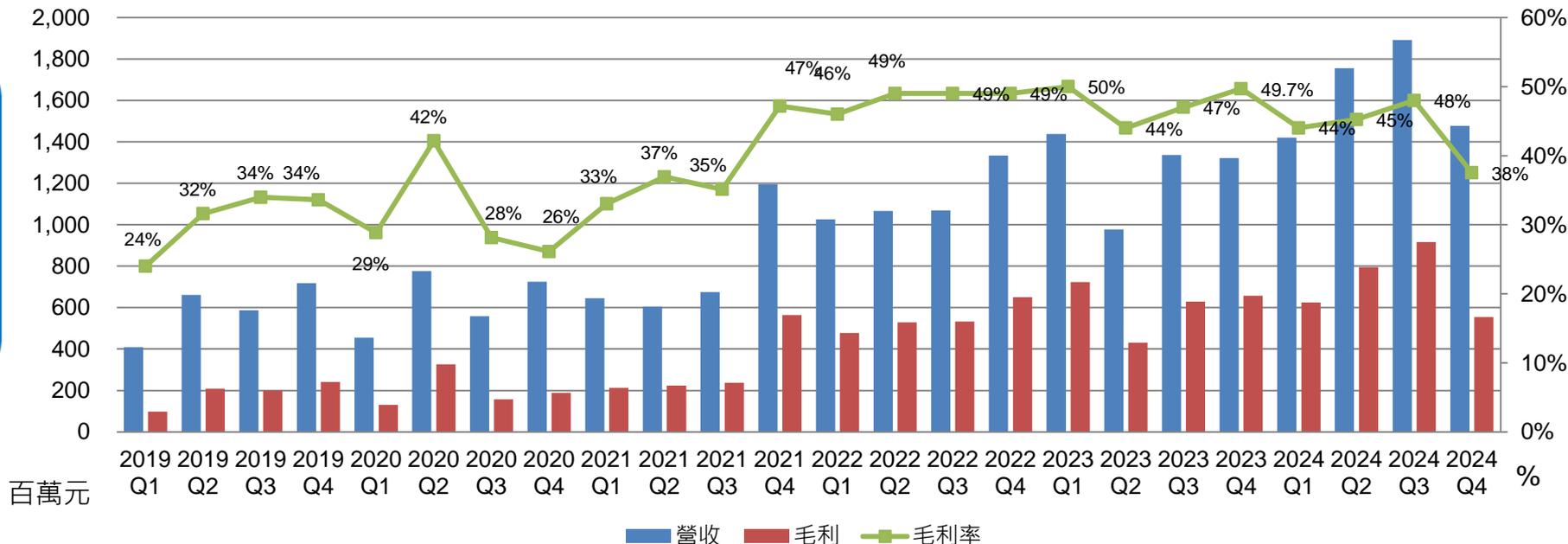


家登集團年營收/EPS





家登每季營收毛利



家登精密



家登集團近五年營收、毛利率、資本支出及總資產



年度	年營收	毛利額	毛利率(%)	EPS	資本支出	資產總額
2019	23.7	7.5	32%	3.24	0.95	48.2
2020	25.1	8.0	32%	6.18	11.30	62.3
2021	31.2	12.4	40%	4.03	20.61	95
2022	44.9	21.9	49%	11.12	7.31	122
2023	50.8	24.4	48%	10.24	13.04	162.9
2024	65.5	28.8	44%	12.32	-	213.7

單位: 億元



家登集團近五年資本支出



年度	土地	建築物	建造中 不動產	機器設備	其他	合計
2019	0.26	0.38	-	0.14	0.17	0.95
2020	6.28	0.88	-	1.02	3.12	11.30
2021	14.53	0.38	2.83	1.69	1.18	20.61
2022	2.31	0.01	1.66	1.27	2.06	7.31
2023	2.05	0.22	5.61	2.77	2.39	13.04
2024 Q3	2.34	1.79	5.86	1.19	1.56	12.74

單位: 億元



家登集團費用及毛利率比較



	2024										2023				
	Q1	YoY %	Q2	YoY %	Q3	YoY %	Q4	YoY %	累計	YoY %	Q1	Q2	Q3	Q4	累計
營收	14.20	-1%	17.56	80%	18.94	42%	14.74	10%	65.45	35%	14.41	9.78	13.37	13.22	50.78
成本	7.95	11%	9.62	74%	9.77	39%	9.19	28%	36.54	38%	7.17	5.53	7.04	6.64	26.39
毛利額	6.25	-14%	7.94	87%	9.17	45%	5.55	-19%	28.91	31%	7.24	4.25	6.33	6.58	24.39
費用率	28%		23%		23%		30%		26%		20%	33%	30%	25%	27%
EPS	2.24		3.00		4.39		2.69		12.32		3.94	1.68	1.94	2.68	10.24

2024 費用說明:

- 隨著家登事業群跨大，因應成長需求組織擴編及併購，使得相關費用增加
- 大中華地區銷售大幅成長，進出口、樣贈費用及傭金費用增加
- 家碩科技機台需調機，故增加呆滯損失/現金增資，增加相關營業費用及營業成本
- 為增加廠內產能，購置相關模具、機台設備等，故逐期攤銷後每月折舊費用提高

單位: 億元



航太事業主力客戶

家登精密



導管、逆止閥、緊固件
及相關加工零件，適用於GE引擎件



提供各式管件及連接管等，
更於廠內進行化工處理及
特殊焊接工段

航太事業起源
「高進入障礙」
「高毛利市場」
「精密加工」



不僅提供板金、加工零件和
管件接頭，更提供
塑膠射出產品



透過3~5軸車銑床加工技術，
提供控制液壓零件，
如缸體、腔體、活塞等



家登航太產品佈局



Honeywell

AEROSPACE



傳輸燃油/冷卻液管&週邊
72% 市佔率

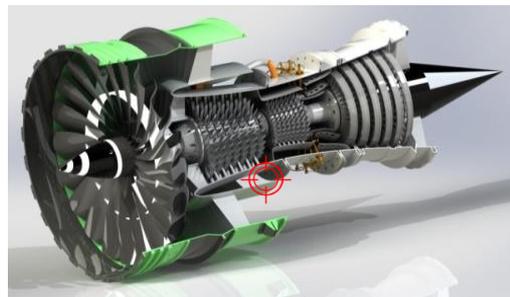


Pratt & Whitney

A United Technologies Company



液壓控制缸體&週邊
48% 市佔率



家登精密



2025年航太事業展望



家登精密



電控系統散熱 & 電系(塑膠)
37% 市佔率



GE Aerospace



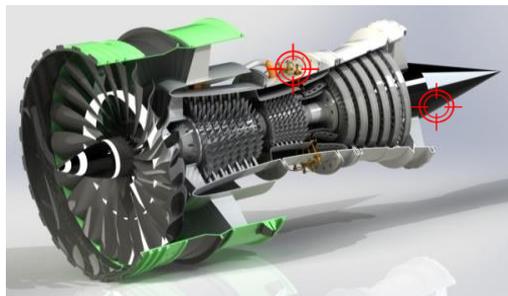
機艙內飾(塑膠)
36% 市佔率



燃油機噴油系統
91% 市佔率



飛機煞車懸吊系統
63% 市佔率



高溫液氣體排放系統
42% 市佔率





家登發展藍圖-五大亮點



家登精密

Gudeng

- 「深耕關鍵客戶」
- 「開拓新客戶」
- 「發展新市場」

三大策略重點聚焦發展

「**協同創新Co-Creation**」
整合上中下游客戶、供應商
尋找優質併購標的
擴展集團事業體

2025 ~

EUV Pod

先進製程持續擴充，High-NA EUV POD等相關需求量大



2025 ~

晶圓載具解決方案

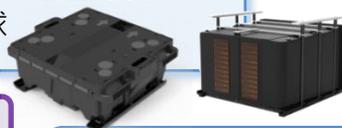
全系列晶圓載具全球市佔不斷攀升，先進封裝市占快速增加，成為大中華關鍵客戶Baseline



2025 Q3 ~

先進封裝系列載具

完整CoWoS及後段先進封裝解決方案領先全球



2026 ~

拓展新技術

持續研發Cooling、化學桶、濾網等相關新技術，拓展新市場



2026 ~

航太事業

航太營收正式挹注，不斷擴充客戶群，挑戰營收翻倍成長





家登ESG實踐績效



榮獲天下永續公民獎 中堅企業 永續百強
榮獲TCSA台灣企業永續獎 企業永續報告 白金級



ESG 評等摘要

上市櫃ESG評等

A

經濟

11-30%

社會

11-30%

環境

31-50%

揭露

11-30%

單位營收碳排量至

2023年減少**33%**
(以2021年為基期)



單位營收用水量至

2023年減少**54%**
(2021年為基期)

單位營收廢棄物至2023年

減少**21%** (2021年為基期)

次料循環利用專案·回收**再製棧板、運輸箱、人體工學椅**

2023年員工平均年薪**21**個月

2023年投入**17**項社會公益行動·效益達**1,600**萬元

2023年提供**185**個優質工作機會



2023年人均薪資福利費用
832,000元



導入ISO22301、ISO20400、ISO 27001

永續報告書
第1類白金級

獲得品質領域最高榮譽
27th 國家品質獎



永續綜合績效獎
台灣100大永續典範企業獎

家登精密

家登永續報告書



2025/3/14



司著作權所有



家登集團整體綜效



營收每年雙位數成長：

自2019年營收超越20億新台幣，2022年達45億元，2023年50.8億，截至**2024**營收達**65.5**億，較去年同期**成長29%**

穩定的毛利率：

2018年突破20%，2022年49%，2023年48%，**2024年44%**

EPS每年持續成長：

2018年為0.27元，2019年3.25元，2022年11.12元，2023年10.24元，**2024年12.32**元

全球載具市占率快速攀升：

光罩盒全球**市占超過70%**、EUV光罩盒**超過85%**、**FOUP晶圓盒**陸續通過大客戶認證，**大中華半數**以上客戶採用家登為baseline

家登集團成長藍圖

2025

- ◆ 晶圓載具國內外市佔**持續擴張**，貢獻強力營收成長
- ◆ 聚焦先進製程，成為關鍵客戶主力供應商
- ◆ 配合CoWoS發展，3D封測(Panel FOUP) **出貨穩定提升**
- ◆ 半導體全方位解決方案領先市場，集團挑戰百億營收

2026

- ◆ 航太關鍵零組件持續驗證並取得長單
- ◆ CoWoS產品強烈挹注營收成長
- ◆ **High-NA EUV成熟量產**，帶來營收貢獻
- ◆ **Immersion Cooling Tank成熟量產**，貢獻強力營收成長
- ◆ 持續建廠擴充產能，完成全球大客戶在地供應及全方位服務

2027

- ◆ 獨家領先**先進封裝全新系列載具**市佔持續擴張
- ◆ 正式插旗**半導體耗材市場**，提供關鍵客戶完整系列產品
- ◆ 加速**擴展航太製程**，搶佔航太市場
- ◆ 持續聚焦高營收市場及併購策略，集團更上層樓





Thank You
www.gudeng.com